



<http://www.asicon.org>

征稿通知

第13届国际专用集成电路会议

The IEEE 13th International Conference on ASIC

2019年10月29日—11月1日, 重庆, 中国

大会共主席

Jan Van der Spiegel
Ting-Ao Tang
Yong Lian
Zhiliang Hong
Xiaoping Zeng

顾问委员会共主席

Chenming Hu
Omar Wing
Richard.M.M.Chen
Hiroshi Iwai
Satoshi Goto
Qianling Zhang

程序委员会共主席

Yinyin Lin
Hidetoshi Onodera
Bin Zhao
Jyi-Tsong Lin
Francois Rivet
Yi Zhao

组织委员会共主席

Mengqi Zhou
Huihua Yu
Min Liu

企业联络

Peng Hu

宣传主席

Mengqi Zhou

秘书长

Fan Ye

主办单位 国际电机与电子工程师协会北京分会
(IEEE Beijing Section)

复旦大学

承办单位 复旦大学

支持单位 IEEE SSCS 上海分支会

IET 上海分会,

中国电子学会 (CIE)

第十三届IEEE国际专用集成电路会议(ASICON 2019)将于2019年10月29日—11月1日在中国重庆举行。这次会议旨在为VLSI电路设计者、ASIC用户、系统集成工程师, IC制造厂商、工艺和器件工程师以及CAD/CAE工具开发者提供一个国际论坛, 介绍他们在各自领域获得的最新进步和研发成果。四天的会议将汇集中外著名专家关于VLSI电路、器件、工艺设计与制造等技术最新发展的主题演讲、论文报告以及资深专家的讲课。大会将评选出优秀学生论文, 并安排EDA工具、制造厂商、IC工艺、器件测试仪器以及最新ASIC产品的展示。会议论文集将具有IEEE的统一书号, **录用并作presentation (包括Oral及Poster)的论文都可被IEEE Xplore和EI 检索。**

征稿范围及要求

征稿主要包括但不局限于以下内容:

I. 集成电路设计技术

[1] 模拟IC

- 放大器
- 数据转换器 (ADC和DAC)
- 功率管理和能量回收电路
- 时钟发生电路, PLL和CDR

[2] 数字IC

- CPU、MCU、GPU和嵌入式处理器
- 机器学习和AI电路
- 可编程器件 (PLD, EPLD, HDPLD, FPGA等)
- 片上网络 (NoC)
- 低功耗技术

[3] 无线、有线通信和光通信IC

- LNA, Mixer, PA, 集成天线与开关
- RF和毫米波收发机
- RFID和IoT电路
- Serdes
- 激光驱动器和TIA

[4] 存储器技术

- DRAM与SRAM
- 闪烁存储器
- 铁电存储器
- 相变存储器, RRAM, MRAM

[5] 传感器、图像处理与医疗电子

